

電子回路基板生産動向(2017年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千㎡)	生産額 (百万)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千㎡)	生産額 (百万)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成29年1月実績	電子回路基板	1,191	36,535	111.0	96.4	1,191	36,535	111.0	96.4
	リジットプリント配線板	818	23,735	107.6	100.7	818	23,735	107.6	100.7
	片面プリント配線板	131	708	105.7	103.5	131	708	105.7	103.5
	両面プリント配線板	361	5,333	106.1	103.4	361	5,333	106.1	103.4
	多層プリント配線板(4層)	172	4,165	114.4	104.8	172	4,165	114.4	104.8
	多層プリント配線板(6~8層)	75	5,004	111.7	99.2	75	5,004	111.7	99.2
	多層プリント配線板(10層以上)	9	1,554	114.9	128.3	9	1,554	114.9	128.3
	ビルトアップ多層配線板	70	6,971	99.0	93.1	70	6,971	99.0	93.1
	フレキシブルプリント配線板	316	4,774	120.8	110.6	316	4,774	120.8	110.6
	片面フレキシブル配線板	84	895	106.4	69.1	84	895	106.4	69.1
	両面・多層フレキシブル配線板	232	3,879	127.0	128.4	232	3,879	127.0	128.4
	モジュール基板	57	8,026	111.7	80.0	57	8,026	111.7	80.0
リジット系モジュール基板	38	7,531	98.3	77.2	38	7,531	98.3	77.2	
その他のモジュール基板	19	495	155.1	173.1	19	495	155.1	173.1	
平成29年2月実績	電子回路基板	1,195	36,907	107.5	95.3	2,386	73,442	109.3	95.8
	リジットプリント配線板	842	24,288	107.1	100.2	1,660	48,023	107.4	100.5
	片面プリント配線板	132	719	102.4	102.0	263	1,427	104.1	102.7
	両面プリント配線板	378	5,504	108.4	105.8	739	10,837	107.3	104.6
	多層プリント配線板(4層)	175	4,282	109.5	105.9	347	8,447	111.9	105.3
	多層プリント配線板(6~8層)	75	5,104	115.5	104.4	150	10,108	113.6	101.8
	多層プリント配線板(10層以上)	10	1,612	109.6	129.4	19	3,166	112.1	128.9
	ビルトアップ多層配線板	71	7,067	93.9	86.6	142	14,038	96.4	89.7
	フレキシブルプリント配線板	297	4,880	108.4	100.0	613	9,654	114.5	105.0
	片面フレキシブル配線板	88	1,067	81.2	69.1	172	1,962	91.9	69.1
	両面・多層フレキシブル配線板	209	3,813	126.1	114.3	442	7,692	126.6	121.0
	モジュール基板	56	7,739	109.7	80.4	113	15,765	110.7	80.2
リジット系モジュール基板	36	7,219	95.4	77.4	75	14,750	96.9	77.3	
その他のモジュール基板	20	520	151.4	179.3	38	1,015	153.2	176.2	
平成29年3月実績	電子回路基板	1,250	40,196	107.5	101.9	3,636	113,638	108.7	97.9
	リジットプリント配線板	874	26,774	107.2	102.5	2,533	74,797	107.3	101.2
	片面プリント配線板	144	760	108.4	108.9	407	2,187	105.6	104.8
	両面プリント配線板	386	5,863	106.4	106.7	1,125	16,700	107.0	105.3
	多層プリント配線板(4層)	174	4,597	104.7	105.5	521	13,044	109.4	105.4
	多層プリント配線板(6~8層)	79	5,553	117.9	108.7	229	15,661	115.0	104.1
	多層プリント配線板(10層以上)	9	1,743	104.4	122.9	28	4,909	109.4	126.7
	ビルトアップ多層配線板	81	8,258	105.3	91.3	223	22,296	99.4	90.3
	フレキシブルプリント配線板	313	4,521	106.1	128.9	926	14,175	111.5	111.6
	片面フレキシブル配線板	88	1,140	101.9	101.8	259	3,102	95.0	78.4
	両面・多層フレキシブル配線板	225	3,381	107.8	141.6	667	11,073	119.5	126.7
	モジュール基板	63	8,901	118.8	90.5	176	24,666	113.4	83.6
リジット系モジュール基板	40	8,301	101.0	86.8	115	23,051	98.3	80.5	
その他のモジュール基板	23	600	173.4	218.2	61	1,615	160.1	189.8	
平成29年4月実績	電子回路基板	1,217	38,129	110.8	102.7	4,852	151,767	109.2	99.0
	リジットプリント配線板	835	25,119	111.1	104.9	3,369	99,916	108.2	102.1
	片面プリント配線板	141	752	120.4	116.0	548	2,939	109.0	107.5
	両面プリント配線板	361	5,482	106.1	106.3	1,486	22,182	106.7	105.6
	多層プリント配線板(4層)	176	4,187	117.9	111.2	696	17,231	111.4	106.7
	多層プリント配線板(6~8層)	69	4,809	111.2	100.0	298	20,470	114.1	103.1
	多層プリント配線板(10層以上)	9	1,755	118.6	132.9	38	6,664	111.6	128.3
	ビルトアップ多層配線板	80	8,134	104.9	98.7	302	30,430	100.8	92.4
	フレキシブルプリント配線板	320	4,701	109.5	114.6	1,246	18,876	111.0	112.3
	片面フレキシブル配線板	96	1,123	126.6	104.0	356	4,225	101.9	83.8
	両面・多層フレキシブル配線板	224	3,578	103.5	118.4	891	14,651	115.1	124.6
	モジュール基板	62	8,309	114.6	91.5	238	32,975	113.7	85.5
リジット系モジュール基板	39	7,740	99.2	88.5	154	30,791	98.5	82.4	
その他のモジュール基板	23	569	154.6	169.9	84	2,184	158.5	184.1	

平成29年5月実績	電子回路基板	1,148	36,253	108.6	105.3	6,000	188,020	109.1	100.2
	リジットプリント配線板	792	23,340	106.8	104.2	4,160	123,256	107.9	102.5
	片面プリント配線板	145	704	122.8	108.6	693	3,643	111.6	107.7
	両面プリント配線板	339	5,355	104.4	104.4	1,825	27,537	106.3	105.3
	多層プリント配線板(4層)	156	3,982	97.9	100.5	852	21,213	108.7	105.5
	多層プリント配線板(6~8層)	67	4,659	107.9	98.2	365	25,129	112.9	102.2
	多層プリント配線板(10層以上)	10	1,631	125.1	126.6	48	8,295	114.2	127.9
	ビルトアップ多層配線板	75	7,009	108.4	105.7	377	37,439	102.2	94.6
	フレキシブルプリント配線板	284	4,041	108.5	106.0	1,531	22,917	110.5	111.2
	片面フレキシブル配線板	91	942	117.3	80.0	447	5,167	104.7	83.1
	両面・多層フレキシブル配線板	193	3,099	104.8	117.6	1,083	17,750	113.1	123.3
	モジュール基板	72	8,872	133.2	108.2	310	41,847	117.7	89.5
	リジット系モジュール基板	41	8,206	113.2	104.7	194	38,997	101.3	86.2
その他のモジュール基板	31	666	173.1	180.5	115	2,850	162.2	183.3	
平成29年6月実績	電子回路基板	1,277	38,858	105.5	100.0	7,278	226,878	108.4	100.2
	リジットプリント配線板	894	26,351	106.5	100.6	5,054	149,607	107.7	102.1
	片面プリント配線板	158	797	125.5	105.8	851	4,440	114.0	107.4
	両面プリント配線板	398	6,086	103.9	106.7	2,223	33,623	105.9	105.6
	多層プリント配線板(4層)	171	4,458	99.7	102.6	1,023	25,671	107.0	105.0
	多層プリント配線板(6~8層)	76	5,283	102.8	102.1	441	30,412	111.0	102.2
	多層プリント配線板(10層以上)	10	1,744	95.0	115.5	57	10,039	110.5	125.6
	ビルトアップ多層配線板	81	7,983	107.6	91.6	458	45,422	103.1	94.1
	フレキシブルプリント配線板	312	4,750	98.9	115.3	1,843	27,667	108.3	111.9
	片面フレキシブル配線板	93	979	86.5	62.5	541	6,146	101.0	79.0
	両面・多層フレキシブル配線板	219	3,771	105.3	147.7	1,302	21,521	111.7	126.9
	モジュール基板	71	7,757	127.4	90.6	381	49,604	119.4	89.7
	リジット系モジュール基板	39	7,114	102.6	87.3	233	46,111	101.5	86.4
その他のモジュール基板	32	643	179.6	157.2	148	3,493	165.7	177.9	
平成29年7月実績	電子回路基板	1,233	39,204	103.0	99.4	8,511	266,082	107.6	100.0
	リジットプリント配線板	865	26,048	104.3	100.8	5,919	175,655	107.2	102.0
	片面プリント配線板	143	739	116.5	107.7	995	5,179	114.3	107.4
	両面プリント配線板	393	6,006	104.3	105.1	2,616	39,629	105.6	105.5
	多層プリント配線板(4層)	174	4,570	104.3	105.2	1,197	30,241	106.6	105.0
	多層プリント配線板(6~8層)	70	5,146	90.6	98.9	510	35,558	107.7	101.7
	多層プリント配線板(10層以上)	9	1,753	93.8	120.8	67	11,792	107.8	124.8
	ビルトアップ多層配線板	75	7,834	99.0	92.9	533	53,256	102.5	93.9
	フレキシブルプリント配線板	291	4,397	92.7	87.9	2,134	32,064	105.9	107.8
	片面フレキシブル配線板	78	1,009	78.5	84.6	618	7,155	97.5	79.7
	両面・多層フレキシブル配線板	213	3,388	98.8	88.9	1,516	24,909	109.7	120.0
	モジュール基板	77	8,759	140.6	101.9	458	58,363	122.5	91.3
	リジット系モジュール基板	43	8,099	108.0	98.2	277	54,210	102.5	88.0
その他のモジュール基板	34	660	227.6	190.8	182	4,153	174.7	179.8	
平成29年8月実績	電子回路基板	1,149	39,498	98.4	100.9	9,660	305,580	106.4	100.2
	リジットプリント配線板	796	24,424	101.2	103.3	6,716	200,079	106.4	102.1
	片面プリント配線板	133	733	102.2	106.9	1,128	5,912	112.8	107.3
	両面プリント配線板	352	5,677	97.4	106.0	2,968	45,306	104.6	105.6
	多層プリント配線板(4層)	162	4,179	109.7	98.2	1,360	34,420	107.0	104.2
	多層プリント配線板(6~8層)	67	4,727	96.3	96.3	578	40,285	106.2	101.0
	多層プリント配線板(10層以上)	8	1,576	93.0	107.1	75	13,368	105.9	122.5
	ビルトアップ多層配線板	74	7,532	105.6	108.0	607	60,788	102.9	95.5
	フレキシブルプリント配線板	270	4,680	85.8	70.7	2,404	36,744	103.2	101.1
	片面フレキシブル配線板	75	816	77.7	79.9	694	7,971	94.9	79.7
	両面・多層フレキシブル配線板	195	3,864	89.8	69.1	1,711	28,773	107.0	109.2
	モジュール基板	82	10,394	124.8	117.0	541	68,757	122.9	94.4
	リジット系モジュール基板	48	9,764	109.0	115.7	325	63,974	103.4	91.3
その他のモジュール基板	34	630	156.3	142.2	216	4,783	171.5	173.7	

平成29年9月実績	電子回路基板	1,240	40,462	96.9	99.4	10,900	346,042	105.2	100.1
	リジットプリント配線板	863	25,763	100.0	97.3	7,578	225,842	105.7	101.5
	片面プリント配線板	153	756	114.3	101.1	1,281	6,668	112.9	106.6
	両面プリント配線板	387	6,242	98.8	110.0	3,355	51,548	103.9	106.1
	多層プリント配線板(4層)	166	4,341	99.1	93.4	1,526	38,761	106.1	102.8
	多層プリント配線板(6~8層)	74	5,164	87.6	95.5	651	45,449	103.7	100.4
	多層プリント配線板(10層以上)	9	1,674	88.8	106.9	84	15,042	103.8	120.5
	ビルトアップ多層配線板	74	7,586	98.3	89.9	681	68,374	102.4	94.8
	フレキシブルプリント配線板	297	5,031	85.0	84.4	2,701	41,775	100.8	98.7
	片面フレキシブル配線板	77	795	83.3	70.2	770	8,766	93.6	78.8
	両面・多層フレキシブル配線板	220	4,236	85.6	87.8	1,931	33,009	104.0	105.8
	モジュール基板	80	9,668	117.6	117.0	621	78,425	122.2	96.7
リジット系モジュール基板	43	8,987	98.4	115.5	368	72,961	102.8	93.7	
その他のモジュール基板	37	681	152.9	141.9	253	5,464	168.5	169.0	
平成29年10月実績	電子回路基板	1,291	41,607	99.9	106.8	12,191	387,649	104.6	100.7
	リジットプリント配線板	887	25,384	102.3	100.5	8,465	251,226	105.3	101.4
	片面プリント配線板	163	812	115.3	107.5	1,443	7,480	113.2	106.7
	両面プリント配線板	391	6,078	99.3	109.1	3,747	57,626	103.4	106.4
	多層プリント配線板(4層)	170	4,234	99.9	102.9	1,696	42,995	105.4	102.8
	多層プリント配線板(6~8層)	76	5,220	96.8	101.2	728	50,669	103.0	100.4
	多層プリント配線板(10層以上)	11	1,708	105.4	117.4	95	16,750	104.0	120.2
	ビルトアップ多層配線板	76	7,332	102.2	89.4	756	75,706	102.4	94.3
	フレキシブルプリント配線板	324	6,017	89.0	98.7	3,025	47,792	99.4	98.7
	片面フレキシブル配線板	92	872	98.4	71.9	862	9,638	94.1	78.1
	両面・多層フレキシブル配線板	232	5,145	85.8	105.4	2,163	38,154	101.7	105.8
	モジュール基板	81	10,206	130.0	133.9	701	88,631	123.0	99.9
リジット系モジュール基板	45	9,573	114.4	132.6	413	82,534	103.9	97.0	
その他のモジュール基板	36	633	156.4	157.1	289	6,097	166.9	167.7	
平成29年11月実績	電子回路基板	1,247	40,112	94.9	104.8	13,438	427,761	103.7	101.1
	リジットプリント配線板	877	25,547	97.5	101.9	9,342	276,773	104.5	101.5
	片面プリント配線板	160	801	107.9	103.4	1,603	8,281	112.6	106.4
	両面プリント配線板	379	6,010	92.2	104.3	4,126	63,636	102.2	106.2
	多層プリント配線板(4層)	178	4,364	98.8	102.7	1,874	47,359	104.7	102.8
	多層プリント配線板(6~8層)	75	5,247	99.4	101.5	803	55,916	102.6	100.5
	多層プリント配線板(10層以上)	10	1,608	99.8	103.4	105	18,358	103.6	118.5
	ビルトアップ多層配線板	76	7,517	100.8	99.5	832	83,223	102.2	94.7
	フレキシブルプリント配線板	298	5,689	84.1	101.9	3,323	53,481	97.8	99.1
	片面フレキシブル配線板	93	1,030	104.9	84.7	955	10,668	95.0	78.7
	両面・多層フレキシブル配線板	205	4,659	77.1	106.7	2,368	42,813	99.0	105.9
	モジュール基板	71	8,876	117.0	116.1	773	97,507	122.4	101.2
リジット系モジュール基板	43	8,320	110.4	115.4	456	90,854	104.5	98.5	
その他のモジュール基板	28	556	128.7	127.8	317	6,653	162.6	163.4	
平成29年12月実績	電子回路基板	1,198	38,849	96.1	107.0	14,635	466,610	103.0	101.6
	リジットプリント配線板	853	24,846	101.3	103.5	10,195	301,619	104.2	101.6
	片面プリント配線板	149	748	101.5	100.0	1,752	9,029	111.6	105.8
	両面プリント配線板	377	5,706	101.8	104.1	4,502	69,342	102.2	106.0
	多層プリント配線板(4層)	174	4,232	104.8	104.3	2,048	51,591	104.8	102.9
	多層プリント配線板(6~8層)	70	5,031	88.1	95.7	873	60,947	101.3	100.1
	多層プリント配線板(10層以上)	10	1,746	121.7	112.1	114	20,104	104.9	117.9
	ビルトアップ多層配線板	73	7,383	104.6	106.8	905	90,606	102.4	95.6
	フレキシブルプリント配線板	281	5,119	81.0	105.2	3,605	58,600	96.2	99.6
	片面フレキシブル配線板	87	920	108.5	94.7	1,042	11,588	96.0	79.8
	両面・多層フレキシブル配線板	194	4,199	73.0	107.8	2,562	47,012	96.4	106.1
	モジュール基板	63	8,884	111.3	119.6	836	106,391	121.5	102.5
リジット系モジュール基板	42	8,397	113.2	119.9	497	99,251	105.2	100.0	
その他のモジュール基板	22	487	107.7	114.3	339	7,140	157.5	158.8	

(出所：経済産業省「機械統計月報」)

(2018/02/15 発表 / 2018/02/15 JPCA作成)

電子回路実装基板生産動向(2017年)

		当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比	
		部品搭載点数 (千個)	生産額 (百万)	部品搭載点数 (%)	生産額 (%)	部品搭載点数 (千個)	生産額 (百万)	部品搭載点数 (%)	生産額 (%)
1月	電子回路実装基板	505,909	10,316	97.7	99.5	505,909	10,316	97.7	99.5
	プリント配線実装基板	496,498	8,440	102.9	100.3	496,498	8,440	102.9	100.3
	モジュール実装基板	9,411	1,876	26.4	96.0	9,411	1,876	26.4	96.0
2月	電子回路実装基板	541,626	10,995	95.5	105.4	1,047,535	21,311	96.5	102.5
	プリント配線実装基板	531,699	8,931	101.1	108.3	1,028,197	17,371	102.0	104.3
	モジュール実装基板	9,927	2,064	23.9	94.6	19,338	3,940	25.1	95.3
3月	電子回路実装基板	519,203	10,988	86.5	97.3	1,566,738	32,299	92.9	100.6
	プリント配線実装基板	509,523	9,187	91.6	99.1	1,537,720	26,558	98.3	102.4
	モジュール実装基板	9,680	1,801	22.0	89.1	29,018	5,741	24.0	93.2
4月	電子回路実装基板	507,805	10,428	87.2	96.8	2,074,543	42,727	91.5	99.7
	プリント配線実装基板	496,718	8,613	91.2	98.4	2,034,438	35,171	96.5	101.4
	モジュール実装基板	11,087	1,815	29.0	89.6	40,105	7,556	25.2	92.3
5月	電子回路実装基板	463,972	10,219	85.3	107.2	2,538,515	52,946	90.3	101.0
	プリント配線実装基板	453,035	8,398	89.1	108.3	2,487,473	43,569	95.0	102.7
	モジュール実装基板	10,937	1,821	30.6	102.6	51,042	9,377	26.2	94.2
6月	電子回路実装基板	504,046	12,169	85.2	112.2	3,042,561	65,115	89.4	103.0
	プリント配線実装基板	494,288	10,044	89.0	113.3	2,981,761	53,613	94.0	104.5
	モジュール実装基板	9,758	2,125	27.3	107.3	60,800	11,502	26.3	96.3
7月	電子回路実装基板	507,144	11,569	85.6	109.2	3,549,705	76,684	88.8	103.8
	プリント配線実装基板	497,291	9,591	89.3	110.7	3,479,052	63,204	93.3	105.4
	モジュール実装基板	9,853	1,978	27.9	102.4	70,653	13,480	26.5	97.2
8月	電子回路実装基板	447,891	10,641	81.7	105.5	3,997,596	87,325	88.0	104.0
	プリント配線実装基板	438,291	8,756	84.7	105.6	3,917,343	71,960	92.2	105.4
	モジュール実装基板	9,600	1,885	31.3	105.2	80,253	15,365	27.0	98.1
9月	電子回路実装基板	503,335	11,313	88.5	103.6	4,500,931	98,638	88.0	104.0
	プリント配線実装基板	493,810	9,296	90.1	102.8	4,411,153	81,256	92.0	105.1
	モジュール実装基板	9,525	2,017	46.3	107.7	89,778	17,382	28.3	99.1
10月	電子回路実装基板	562,304	11,830	95.3	102.7	5,063,235	110,468	88.8	103.9
	プリント配線実装基板	552,546	9,613	96.7	102.0	4,963,699	90,869	92.5	104.8
	モジュール実装基板	9,758	2,217	52.1	105.6	99,536	19,599	29.6	99.8
11月	電子回路実装基板	536,294	11,329	85.8	94.9	5,599,529	121,797	88.5	103.0
	プリント配線実装基板	526,444	9,190	86.8	94.5	5,490,143	100,059	91.9	103.7
	モジュール実装基板	9,850	2,139	54.1	96.7	109,386	21,738	30.9	99.5
12月	電子回路実装基板	552,646	11,427	96.4	99.2	6,152,175	133,224	89.2	102.6
	プリント配線実装基板	543,012	9,305	97.0	97.9	6,033,155	109,364	92.3	103.2
	モジュール実装基板	9,634	2,122	72.9	105.4	119,020	23,860	32.4	100.0

(出所：経済産業省「機械統計月報」)

(2018/02/15 発表 / 2018/02/15 JPCA作成)